ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

LGA50

Высококачественные тестовые площадки типа LGA шагом сетки 0.4-0.5 мм

Площадки с шагом сетки 0,5 мм+ обеспечивают устойчивое и надежное испытание и проверку высокочастотных компонентов, а также систем с высокой повторяемостью результатов

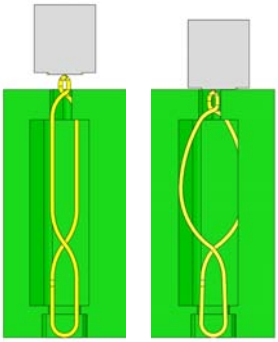
Компания HSIO Technologies разработала тестовые площадки LGA50 в строгом соответствии с требованиями к надежности высококачественного сигнала для испытания высокочастотных компонентов и систем. Эти высокоэффективные, нормированные панельки с устройством прижатия испытательные удовлетворяют широкому спектру стандартов и размеров корпуса, а также количества вводов-выводов. Испытание МС в корпусе LGA при помощи испытательных площадок LGA50 обеспечивает успешное выполнение следующих задач:

- Межплатное соединение
- Разработка и определение характеристик
- Экранирование устройства
- Предназначен для эксплуатации при высокой температуре и напряжении
- Разработка и оценка программного обеспечения
- Предназначен для эксплуатации при больших токах
- Валидация платформы
- Испытание на принудительный отказ
- Маркетинг и оценка монтажных схем

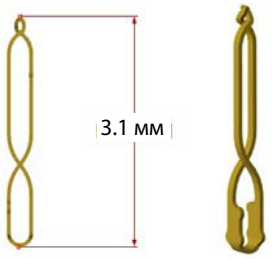
ПРИМУЩЕСТВА

Надежность сигнала	Короткий путь прохождения сигнала достигается низкими потерями, внесенными и индуктивности обеспечивая превосходное электрическое соединение.
Взаимозаменяемость контактных групп	Использование разъемов с взаимозаменяемыми группами контактов значительно снижает затраты по сравнению с покупкой нового разъема.
Механическая прочность	Многоточечный контакт и большой рабочий диапазон в вертикальной плоскости обеспечивает устойчивое сопротивление контакта при любых размерах используемого корпуса.
Высокая эффективность по времени	Размещение пассивного компонента возле устройства, интегрированного в стандартный корпус разъема, обеспечивает превосходные электрические характеристики при использовании стандартных конструкций и сокращает время подготовки к технологическому процессу.
Универсальность и экономическая эффективность	Испытательные панельки LGA50 спроектированы с учетом существующих требований к надежности, высокому качеству, эффективности и экономичности для большинства применяемых устройств, платформ и системных измерений.

МЕТОДОЛОГИЯ



КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальная характеристика	Миниатюрные штампованные контакты типа BeCu обеспечивают сверхкороткий путь прохождения сигнала.
Многоточечный контакт	Контакт LGA50 входит в зацепление с устройством при помощи двух резервных контактных точек.
Большой диапазон механической работы	Контакт LGA50 имеет большой рабочий диапазон в вертикальной плоскости благодаря проходному соединению устройства к печатной плате.
Контактные группы	Возможность легкой замены контактных групп при эксплуатации
Разъединение вблизи устройства	Мелкие шаги сетки наряду с крупными гнездами разрыва, спроектированные для корпусов стандартных размеров, позволяют размещать пассивные компоненты вблизи устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

	Высота 0.8 мм
Время задержки	16.5 пс
Собственная индуктивность	0.96 нГ
Взаимная индуктивность	0.146 нГ
Емкость при заземлении	0.248 пФ
Взаимная емкость	0.030 пФ
Вносимые потери -1 дБ	17 ГГц
Импеданс	60.2 Ω

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сила тока	2 А (свободный воздух)
Контактное сопротивление	<25 миллиом
Срок службы	15000 циклов сопряжения
Нормальная сила	25-35 грамм/контакт
Вертикальное сжатие	0.15 мм @ с шагом 0.5 мм, 0.2 мм @ с шагом 0.8 мм, 0.3 мм @ с шагом 1.0 мм

Рабочие характеристики площадки

Обладая шагом 0.5 мм+, разъемы тестирования LGA50 доступны для широкого диапазона сеток, включая разработку заказных приборов. Уникальная конструкция контакта обеспечивает высокую точность передачи сигнала для современных высокочастотных приложений. Кроме того, каждый из этих разъемов тестирования спроектирован таким образом, чтобы минимизировать дорогостоящую полезную площадь печатной платы, обеспечивая предельно близкое размещение развязывающего компонента. Кроме того, заказчик может по своему усмотрению выбирать тип крышки разъема (болтовую или шарнирную), способ теплотвода (с водяным или воздушным охлаждением), а также другие конфигурации.

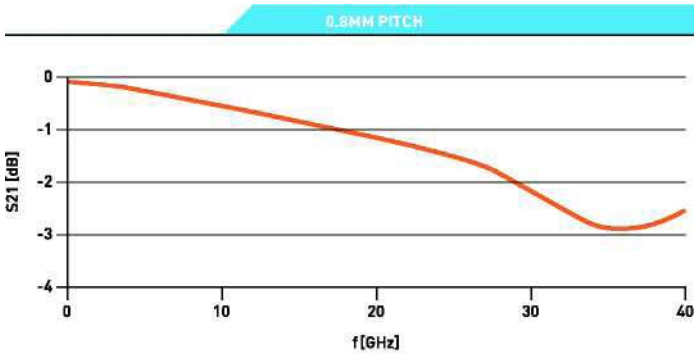
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал изготовления контакта и покрытия	Медный сплав (Cu) Олово (Sn) или Золото (Au) поверх никеля (Ni)
Высота контакта	3.1 мм
Корпус	Полимид(Cirlex®)
Условия эксплуатации	-40° C - 150° C (-40° F - 302° F)

Технические параметры могут отличаться в зависимости от приложения и требований о соответствии. По запросу возможно предоставление дополнительной информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шаг сетки 0.8 мм



Разъем модели LGA50 для корпусов LG (3 мм x 3 мм до 12 мм x 12 мм) и QFN.

©Copyright2012.
HSIO Technologies,LLC/ All right reserved/ Data subject to change without notice HSIO Technologies, LLC/13300 67th Avenue North, Maple Grove, MN 55311 USA. +1.763.447.6260/ Sales@HSIOTech.com/ www.HSIOTech.com

ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Россия, 115404, г.Москва,
11-я Радиальная ул., д.2,офис 20
Тел./Факс: +7.499.218.2360 /
info@eltm.ru / www.eltm.ru